
SHIELD FINGER 3525/3525-Z
シールドフィンガー 3525/3525-Z

注記) 4ページ以降日本語版

1. Scope

This specification applies to the SHIELD FINGER 3525/3525-Z which is used for grounding terminal between a printed wiring board and a metal frame.

2. Relevant Standards

The standards below are applicable as part of this specification.

JIS (Japanese Industrial Standard)

3. Types

SHIELD FINGER 3525 : Cat. No. : 1447009-7

SHIELD FINGER 3525-Z : Cat. No. : 1447009-8

4. Material

Contact: Beryllium Copper Alloy (JIS C1720R)

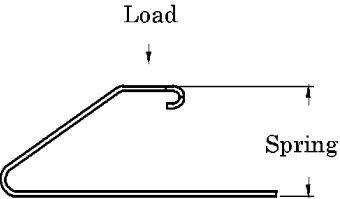
Plating: Gold Plate 0.05 μ m MIN. Over Nickel Plate

5. Shape and Dimensions

SHIELD FINGER 3525 : As per Drawing [1447009-7]

SHIELD FINGER 3525-Z : As per Drawing [1447009-8]

6. TEST PROCEDURES AND PERFORMANCE

| No. | Title | Test Procedures | Performance |
|-------|------------------------|--|--|
| 6.1 | Mechanical Performance | | |
| 6.1.1 | Spring Capacity | <p>Measure the spring force, after making 10 times flexion to take one's position at 2mm/min. speed.</p>  <p>The diagram shows a mechanical spring component. It consists of a horizontal top arm, a diagonal arm, and a horizontal bottom arm. A downward-pointing arrow labeled 'Load' is positioned above the top arm. A vertical dimension line on the right side of the top arm is labeled 'Spring', indicating the height of the spring.</p> | <p>As spring height 2.5mm Spring Force: 0.2N (20gf) min.</p> |

| No. | Title | Test Procedures | Performance | | | | |
|---------------------------|------------------------------------|---|---------------------------|-----------|--------------------------|--------------|---|
| 6.2 | Process Compatibility Requirements | | | | | | |
| 6.2.1 | Solderability | <p>The solderability test shall be performed per JIS C0050.</p> <table border="1" data-bbox="402 821 979 905"> <tr> <td data-bbox="402 821 769 863">Melted solder Temperature</td> <td data-bbox="769 821 979 863">235 ± 5°C</td> </tr> <tr> <td data-bbox="402 863 769 905">Immersion Time in Solder</td> <td data-bbox="769 863 979 905">3 ± 0.5 sec.</td> </tr> </table> | Melted solder Temperature | 235 ± 5°C | Immersion Time in Solder | 3 ± 0.5 sec. | <p>The solder tails shall have been covered with new solder over a minimum of 75% of the solderable area.</p> |
| Melted solder Temperature | 235 ± 5°C | | | | | | |
| Immersion Time in Solder | 3 ± 0.5 sec. | | | | | | |

1. 適用範囲

本仕様書は、プリント基板とシャーシ部材等との接続に用いられるアース用金具、シールドフィンガー 3525/3525-Z について規定する。

2. 適用規格

以下の規格を本仕様書の一部として適用する。

JIS (Japanese Industrial Standard: 日本工業規格)

3. 適用型番

本仕様書は、以下の製品型番に対して適用される。

- ・シールドフィンガ-3525 : 型番1447009-7
- ・シールドフィンガ-3525-Z : 型番1447009-8

4. 材質

金属材料 : JIS C1720R ベリリウム銅 (ミルハードン材)

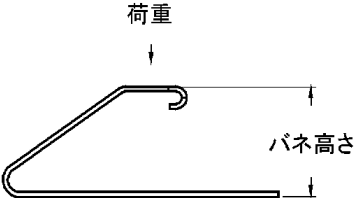
メッキ : ニッケル下地金メッキ0.05 μ m MIN. (前めっき)

5. 形状及び寸法

図面による。

- ・シールドフィンガ-3525 : 1447009-7
- ・シールドフィンガ-3525-Z : 1447009-8

6. 試験方法及び性能

| 番号 | 項目 | 試験方法 | 性能 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|--|------|----------|------|-----|--|-----|------|-----|---------------|-------|----------------|-----------------|-------|----------------|
| 6.1 | 機械的性能 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | バネ特性 | <p>試料に図示の方向から所定のバネ高さまでたわみを繰り返し与え、試験後のバネ圧を測定する。</p> <table border="1" data-bbox="483 793 813 856"> <tr> <td>繰返速度</td> <td>2mm/min.</td> </tr> <tr> <td>繰返回数</td> <td>10回</td> </tr> </table>  | 繰返速度 | 2mm/min. | 繰返回数 | 10回 | <table border="1" data-bbox="1052 779 1479 894"> <thead> <tr> <th>製品名</th> <th>バネ高さ</th> <th>バネ圧</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>シールドフィンガ-3525</td> <td>2.5mm</td> <td>0.2N(20gf)min.</td> </tr> <tr> <td>シールドフィンガ-3525-Z</td> <td>2.5mm</td> <td>0.4N(40gf)min.</td> </tr> </tbody> </table> | 製品名 | バネ高さ | バネ圧 | シールドフィンガ-3525 | 2.5mm | 0.2N(20gf)min. | シールドフィンガ-3525-Z | 2.5mm | 0.4N(40gf)min. |
| 繰返速度 | 2mm/min. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰返回数 | 10回 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 製品名 | バネ高さ | バネ圧 | | | | | | | | | | | | | | |
| シールドフィンガ-3525 | 2.5mm | 0.2N(20gf)min. | | | | | | | | | | | | | | |
| シールドフィンガ-3525-Z | 2.5mm | 0.4N(40gf)min. | | | | | | | | | | | | | | |

| 番号 | 項目 | 試験方法 | 性能 | | | | | | |
|--------|---------|---|------|--------|--------|---------|-------|--------|---|
| 6.2 | 実装適合性 | | | | | | | | |
| 6.2.1 | 半田付性 | <p>JIS 00050に基づき、下記の条件で試験を行う。</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>半田温度</td> <td>235±5℃</td> </tr> <tr> <td>半田浸漬時間</td> <td>3±0.5 秒</td> </tr> <tr> <td>フラックス</td> <td>NA-200</td> </tr> </table> | 半田温度 | 235±5℃ | 半田浸漬時間 | 3±0.5 秒 | フラックス | NA-200 | <ul style="list-style-type: none"> 半田付け部の75%以上が新しい半田コーティングで覆われること。(破断面は除く) |
| 半田温度 | 235±5℃ | | | | | | | | |
| 半田浸漬時間 | 3±0.5 秒 | | | | | | | | |
| フラックス | NA-200 | | | | | | | | |